

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 3 日收到上海证券交易所出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕21 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就《审核问询函》所提问题逐项进行了认真核查及回复，对重组报告书进行了相应修订，形成了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”），本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
重大事项提示	更新了上市公司实际控制人及其一致行动人在业绩承诺期内的股份锁定承诺
重大风险提示	更新了商誉减值的风险
第一章 本次交易概况	1、更新了上市公司与标的公司主营业务的协同效应 2、更新了关于股份锁定的承诺函
第三章 交易对方基本情况	更新了部分交易对方的基本信息等
第六章 标的资产评估情况	更新了本次交易的定价公允性分析
第七章 本次交易主要合同	更新了标的公司后续经营管理的相关内容

章节	修订情况
第九章 管理层讨论与分析	1、根据《审核问询函》要求，补充披露对标的公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的具体整合管控计划 2、根据《审核问询函》要求，补充披露标的公司划分资产组的方法、过程和依据，是否符合《企业会计准则》的要求
第十二章 风险因素分析	更新了商誉减值的风险

除上述主要修订调整外，公司已对《重组报告书（草案）》全文进行了梳理和自查，考虑上下文联系、可读性及数据准确性，公司对《重组报告书（草案）》的部分段落、文字表述进行了优化调整，详见《重组报告书（草案）》楷体加粗部分内容。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日